



# Bui Thanh Tung

University of Engineering and Technology,  
Vietnam National University, Hanoi  
MEMS

Google Scholar

Chỉ mục trích dẫn	Tất cả	Từ 2011
Trích dẫn	205	189
h-index	7	7
i10-index	4	4

Tiêu đề 1–20

Trích dẫn bởi Năm

## [Bipolar corona discharge based air flow generation with low net charge](#)

VT Dau, TX Dinh, T Terebessy, TT Bui

Sensors and Actuators A: Physical 244, 146-155

2016

## [Một số hợp chất phân lập từ rễ cây đan sâm \(Salvia miltiorrhiza Bunge\) trồng ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai](#)

NH Tùng, NT Hải, VĐ Lợi, BT Tùng, NT Vững, BH Cường

Tạp chí Dược học 56 (4), 43-47

2016

## [Fabrication and stress analysis of annular-trench-isolated TSV](#)

W Feng, TT Bui, N Watanabe, H Shimamoto, M Aoyagi, K Kikuchi

Microelectronics Reliability

2016

## [Copper-Filled Through-Silicon Vias With Parylene-HT Liner](#)

TT Bui, N Watanabe, X Cheng, F Kato, K Kikuchi, M Aoyagi

IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology 6 (4 ...

2016

## [Nghiên cứu tác dụng ức chế enzym tyrosinase của các phân đoạn tách chiết từ ý dĩ](#)

BT Tùng, VĐ Lợi, LTT Hường, NTT Bình, NT Hải

Tạp chí Dược học 56 (1), 31-35

2016

## [Jet flow generation in a circulatory miniaturized system](#)

VT Dau, TX Dinh, TT Bui

Sensors and Actuators B: Chemical 223, 820-826

1 2016

## [Absolute pressure sensing with bipolar corona discharge: Design, simulation and experimental validation](#)

VT Dan, TT Bui, TX Dinh, T Terebessy, HT Phan

2016 IEEE 29th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems ...

2016

## [3次元IC積層実装技術の実用化への取り組み](#)

青柳昌宏, 居村史人, 加藤史樹, 菊地克弥, 渡辺直也, 鈴木基史, 仲川博, ...

Synthesiology 9 (1), 1-14

2016

## [Pressure sensor based on bipolar discharge corona configuration](#)

VT Dau, TT Bui, TX Dinh, T Terebessy

Sensors and Actuators A: Physical 237, 81-90

2 2016

## [Study on the PZT diaphragm actuated multiple jet flow in a circulatory miniaturized system](#)

TT Bui, TX Dinh, PT Hoa, VT Dau

SENSORS, 2015 IEEE, 1-4

2015

## [Differential capacitively coupled contactless conductivity detection \(DC4D\)](#)

[Differential capacitively coupled contactless conductivity detection \(DCCD\) sensor for detection of object in microfluidic channel](#) 2015  
 QL Do, TT Bui, TTH Tran, K Kikuchi, M Aoyagi, TC Duc  
 SENSORS, 2015 IEEE, 1-4

[Xây dựng mô hình toán học mới nhằm phát hiện hợp chất ức chế hệ thống ubiquitin-proteasome chỉ từ thông tin cấu trúc phân tử](#) 2015  
 LTT Hường, VĐ Lợi, BT Tùng, PT Hải  
 Tạp chí Dược học 55 (10), 58-63

[Twice-etched silicon approach for via-last through-silicon-via with a Parylene-HT liner](#) 2 2015  
 TT Bui, N Watanabe, M Aoyagi, K Kikuchi  
 3D Systems Integration Conference (3DIC), 2015 International, TS8. 6.1-TS8. 6.4

[A method enabling height-control of chips for edge-emitting laser stacking](#) 2015  
 BT Tung, L Ma, T Amano, K Kikuchi, M Mori, M Aoyagi  
 Japanese Journal of Applied Physics 54 (4S), 04DB02

[Dược di truyền học: Các vấn đề liên quan trong điều trị tăng huyết áp](#) 2015  
 BT Tùng, LTT Hường, NH Tùng, PT Hải, DTL Hương, NT Hải, TM Koóng  
 Tạp chí Dược học 55 (6), 02-05

[Silver screen printed transmission lines-analyzing the influence of substrate roughness on the RF performance up to 30 GHz](#) 2014  
 YY Lim, YM Goh, M Yoshida, TT Bui, T Vincent, M Aoyagi, C Liu  
 Electronics Packaging Technology Conference (EPTC), 2014 IEEE 16th, 22-26

[Copper filled TSV formation with Parylene-HT insulator for low-temperature compatible 3D integration](#) 1 2014  
 BT Tung, X Cheng, N Watanabe, F Kato, K Kikuchi, M Aoyagi  
 3D Systems Integration Conference (3DIC), 2014 International, 1-4

[Fabrication and electrical characterization of Parylene-HT liner bottom-up copper filled through silicon via \(TSV\)](#) 6 2014  
 BT Tung, X Cheng, N Watanabe, F Kato, K Kikuchi, M Aoyagi  
 CPMT Symposium Japan (ICSJ), 2014 IEEE, 154-157

[Capacitive sensor based on PCB technology for air bubble inside fluidic flow detection](#) 2 2014  
 T Vu Quoc, T Pham Quoc, T Chu Duc, TT Bui, K Kikuchi, M Aoyagi  
 SENSORS, 2014 IEEE, 237-240

[High-precision integration approach based on alignment maintaining flip-chip bonding using cone shaped bump and truncated pyramid pad](#) 2014  
 BT Tung, L Ma, T Amano, K Kikuchi, M Aoyagi  
 Optical MEMS and Nanophotonics (OMN), 2014 International Conference on, 105-106

*Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương trình máy tính ước tính và tự động xác định.*